



TK Capital Group
德肯資產管理股份有限公司

德肯投資研究報告

昇騰 AI 晶片-華為全國產中國算力芯臟

2026 年 7 月 6 日

TK Capital Group

德肯資產管理股份有限公司

摘要

截至 2026 年 7 月 6 日，華為昇騰 AI 晶片透過“以通訊補算力、以系統補單點”的非對稱競爭策略，憑藉自研 HBM、高速互聯及雙程式設計模型等技術，在中國市場構建了強大競爭力，預計 2026 年將佔據國內 50% 的市場份額。其昇騰 950 系列已於 2026 年 Q1 開始量產，FP4 算力達 2 PFLOPS，為競品 H20 的 2.87 倍，後續 960/970 晶片預計在 2027-2028 年實現算力倍增。在 A 股產業鏈中，最受惠的三家核心公司分別是伺服器整機龍頭**高新發展（000628）**、高速互聯核心供應商**華豐科技（688629）**和軟體生態與整合核心橋樑**軟通動力（301236）**。

展望 2026-2028 年，這三家公司將展現出不同的增長正規化：高新發展（000628）將伴隨昇騰晶片放量而實現規模驅動的業績爆發；華豐科技（688629）將因技術迭代驅動產品“量價齊升”，展現出最強的業績彈性；而軟通動力（301236）則將隨著昇騰生態的深化，從大型專案交付逐步轉向平臺化運營，實現更具持續性的增長。它們分別從硬體整合、核心部件和軟體應用三個層面，共同構築了昇騰產業閉環的戰略支柱。

目錄

1. 華為昇騰 AI 晶片發展路線圖與技術演進 (2026-2028)	4
1.1 昇騰 950 系列：2026 年推理與訓練的雙軌佈局.....	4
1.2 昇騰 960 與 970：2027-2028 年的效能飛躍.....	4
2. 昇騰 AI 晶片的核心技術優勢與同業競爭力分析.....	6
2. 昇騰 AI 晶片的核心技術優勢與同業競爭力分析.....	6
3. 昇騰 AI 晶片的生態系統建設與商業化落地.....	10
4. A 股華為昇騰產業鏈全景圖譜.....	13
4.1 硬體核心供應商.....	13
4.2 軟體合作夥伴與系統整合商.....	14
5. 最受惠於昇騰產業發展的三家核心 A 股公司分析.....	16
高新發展 (000628)：昇騰伺服器生態的領軍者.....	17
華豐科技：高速互聯關鍵節點的“隱形冠軍”.....	17
軟通動力 (301236)：昇騰軟體生態與整合的核心橋樑.....	17
6. 高新發展 (000628)：昇騰伺服器生態的領軍者.....	18
6.1 戰略定位與核心競爭力.....	18
6.2 市場地位與財務表現.....	18
7. 華豐科技：高速互聯關鍵節點的“隱形冠軍”.....	19
7.1 戰略定位與核心競爭力.....	19
7.2 財務表現與客戶分析.....	19
7.3 風險與挑戰.....	20
8. 軟通動力 (301236)：昇騰軟體生態與整合的核心橋樑.....	21
8.1 戰略定位與核心競爭力.....	21
8.2 市場地位與業務進展.....	21
9. 核心三家公司未來三年 (2026-2028) 發展狀況推演.....	22
9.1 高新發展 (000628)：伴隨昇騰放量持續成長，關注資產整合.....	22
9.2 華豐科技 (688629)：技術迭代驅動價值提升，橫向拓展可期.....	22
9.3 軟通動力 (301236)：生態深化與行業滲透共促增長.....	23
10. 總結與展望：昇騰產業浪潮下的核心機遇與未來格局.....	24
10.1 昇騰 AI 晶片：以系統級創新重塑國產算力競爭格局.....	24
10.2 產業鏈價值傳導：硬體先行，軟體與應用緊隨其後.....	24
10.3 三大核心標的：構築產業閉環的戰略支柱.....	24
10.4 未來三年 (2026-2028) 發展推演：從高速增長到生態深化.....	24
10.5 投資策略建議：聚焦核心，長期佈局.....	25

1. 華為昇騰 AI 晶片發展路線圖與技術演進 (2026-2028)

華為昇騰 AI 晶片的技術演進路線圖，其核心邏輯並非單純追求單晶片算力指標的線性超越，而是透過“以通訊補算力、以系統補單點”的非對稱競爭策略，構建一個從晶片微架構、資料型別到叢集互聯的全棧式最佳化體系，以此對沖先進製程的獲取限制。

1.1 昇騰 950 系列：2026 年推理與訓練的雙軌佈局

昇騰 950 系列透過“一芯雙構”的差異化策略，精準切分 AI 大模型推理與訓練的核心場景，實現了從通用化設計向場景化定製的關鍵轉變。

昇騰 950PR (推理 Prefill)

- **市場定位：**專為大模型預填充 (Prefill)、推薦系統等計算密集型推理場景最佳化，已於 2026 年 Q1 實現規模量產。
- **核心算力：**單晶片 FP8 算力達 1 PFLOPS，FP4 算力為 2 PFLOPS，據稱其 FP4 算力為英偉達 H20 的 2.87 倍。
- **記憶體系統：**搭載 128GB 自研 HiBL 1.0 HBM，記憶體頻寬為 1.6TB/s。
- **互聯頻寬：**採用靈衢 2.0 互聯協議，頻寬達到 2TB/s，單跳時延降至 200ns。

昇騰 950DT (訓練/解碼)

- **市場定位：**聚焦於大模型訓練及長文字解碼 (Decode) 等頻寬瓶頸型場景，預計 2026 年 Q4 量產。
- **核心算力：**與 950PR 保持一致，FP8 算力為 1 PFLOPS，FP4 算力為 2 PFLOPS。
- **記憶體系統：**升級至 144GB 自研 HiZQ 2.0 (朱雀) HBM，記憶體頻寬大幅提升至 4TB/s，較 950PR 提升 150%。
- **互聯頻寬：**與 950PR 持平，為 2TB/s。

該系列的技術突破不僅在於引數，更在於底層架構的革新。其採用的 SIMD/SIMT 雙程式設計模型，打破了傳統 NPU 的侷限，顯著提升了處理不規則資料 (如大模型解碼) 的靈活性。同時，記憶體訪問粒度從 512 位元組最佳化至 128 位元組，大幅提升了碎片化資料的處理效率。

1.2 昇騰 960 與 970：2027-2028 年的效能飛躍

基於 950 系列奠定的架構基礎，昇騰 960 與 970 旨在透過持續的效能倍增，進一步縮小與國際頂尖水平的差距，直接對標英偉達 Blackwell 及 Rubin+ 架構。

效能迭代路徑：

- **昇騰 960 (預計 2027Q4)：**算力相較於 950 系列實現翻倍，FP8 算力達到 2 PFLOPS，FP4 算力達到 4 PFLOPS。HBM 容量預計將翻倍至 288GB，記憶體頻寬大幅提升至 9.6TB/s，互聯頻寬增至 2.2TB/s。
- **昇騰 970 (預計 2028Q4)：**算力在 960 基礎上再度翻倍，FP8 算力達到 4 PFLOPS，FP4 算力達到 8 PFLOPS。HBM 容量維持在 288GB，但記憶體頻寬預計將躍升至 14.4TB/s，互聯頻寬實現翻倍，達到 4TB/s。

這一階段的演進，標誌著昇騰晶片從單點技術突破轉向系統效能的全面領先。其核心驅動力源於對 AI 負載特性的深度理解，以及在低精度格式 (如支援自研 HiF4)、互聯協議和記憶體子系統上的持續創新，旨在構建一個即使在不依賴最先進製程的情況下，依然具備強大競爭力的自主算力體系。

2. 昇騰 AI 晶片的核心技術優勢與同業競爭力分析

2. 昇騰 AI 晶片的核心技術優勢與同業競爭力分析

昇騰 AI 晶片的競爭力無法透過孤立的硬體指標線性衡量，其核心壁壘在於透過系統級架構創新與全棧軟體生態的深度協同，構建了一個高度適應中國市場的非對稱競爭體系。

核心技術優勢：以系統協同與生態閉環構建非對稱競爭力

華為昇騰的戰略核心並非在單晶片效能上與對手進行“軍備競賽”，而是轉向“以通訊補算力、以系統補單點”的差異化路徑。這一戰略由四大技術支柱共同支撐，形成了一個從底層硬體到上層應用的垂直整合體系。

- **自研 HBM 技術**：面對外部 HBM 供應鏈的限制，華為透過自研 HiBL/HiZQ HBM 技術，旨在突破記憶體頻寬與容量的瓶頸。這一策略不僅關乎效能，更是保障 AI 算力底座自主可控、應對供應鏈風險的關鍵舉措，直接決定了昇騰晶片在處理大模型時的記憶體牆上限。
- **SIMD/SIMT 雙程式設計模型**：昇騰 950 系列及後續產品在微架構上同時支援 SIMD（單指令多資料）和 SIMD/SIMT（單指令多執行緒）程式設計模型，標誌著其正從傳統的 NPU 向更通用的 GPGPU 架構轉型。這一轉變的核心目標是提升對主流 AI 框架（如 PyTorch）的相容性，大幅降低開發者將基於 CUDA 的模型遷移至昇騰平臺的成本和門檻，是構建開放生態的技術前提。
- **靈衢 (UnifiedBus) 互聯協議**：靈衢協議是華為實現“以通訊補算力”戰略的核心技術，它將資料中心內部的計算、儲存、網路資源池化，透過統一協議實現匯流排級互聯。相較於 NVIDIA 的 NVLink-C2C，靈衢旨在構建一個更開放的元件生態，允許第三方硬體即插即用。其在超節點架構中實現的頻寬提升和通訊延遲降低，是昇騰叢集在多卡通訊密集型的大模型訓練任務中提升有效算力的關鍵。
- **全格式精度支援與記憶體訪問最佳化**：昇騰晶片支援 FP8、MXFP8、HiF8 乃至 MXFP4/HiF4 等多種低精度資料格式，能夠根據不同 AI 負載靈活選擇最優的精度，以實現算力利用率和能效的最大化。同時，透過將記憶體訪問粒度最佳化至 128 位元組，顯著提升了快取利用率，降低了訪存延遲，從而在推薦系統、推理等特定場景中獲得顯著的效能優勢。

2.1 與國際龍頭（英偉達）的關鍵指標對比

在與國際龍頭的競爭中，昇騰的策略並非全面對標，而是在特定市場和場景下尋求效能與效率的突破。其競爭力體現在系統層面和特定精度下的效能表現。

對比維度	華為昇騰 (以 950PR/DT 為例)	英偉達 (以 H100/H20 為例)	競爭力分析
核心算力 (FP4)	昇騰 950PR FP4 算力為 1P-2P	H20 FP4 算力約為 0.7P	昇騰 950PR 在 FP4 精度下，理論算力約為 H20 的 2.87 倍，在低精度推理場景具備顯著效能優勢。
HBM 容量/頻寬	950DT HBM 容量 144GB，頻寬 4TB/s	H20 HBM 容量為 96GB-141GB	昇騰 950DT 在 HBM 容量上超出 H20 約 16%-50%，記憶體頻寬優勢明顯，有助於處理更大模型或批

對比維度	華為昇騰 (以 950PR/DT 為例)	英偉達 (以 H100/H20 為例)	競爭力分析
			次。
互聯頻寬	昇騰 950PR 互聯頻寬達 2TB/s	H100 NVLINK 頻寬約 0.9TB/s	華為延續其在通訊領域的優勢，以高速互聯技術彌補單晶片算力可能存在的差距，提升叢集擴充套件效率。
功耗 (TDP)	昇騰 950PR 功耗約為 600W	H100 SXM 功耗約為 700W	在相近的功耗水平下，昇騰透過系統級最佳化尋求更高的能效比，但具體表現高度依賴於負載和軟體最佳化。
關鍵場景效能	推理吞吐量據稱快 60%	基於 H100 的最佳化方案	在 LLaMA3 等大模型訓練中，昇騰 384 超節點叢集效能提升約 2.5 倍，證明瞭其系統協同架構的有效性。

綜合分析：昇騰在硬體指標上，特別是在互聯頻寬和 HBM 配置上，展現出對標甚至超越 NVIDIA Hopper 架構 (H100) 部分特性的意圖。然而，其核心競爭力並非源於單點效能的超越，而是透過軟硬體協同和系統級最佳化，在特定精度（如 FP4）和特定場景（如推理、MoE 架構訓練）中構建區域性優勢。其挑戰在於，這種優勢的發揮高度依賴於與 MindSpore 框架的深度適配，在全球範圍內與成熟的 CUDA 生態競爭仍需時日。

2.2 在國內市場（寒武紀、海光資訊）的競爭地位

在國內市場，華為昇騰憑藉其全棧自研能力和強大的品牌影響力，正迅速確立領導地位，與國內友商形成顯著差異化優勢。

- **市場份額：**根據 Bernstein Research 的預測，到 2026 年，華為將佔據中國 AI 晶片市場 50% 的份額，遠超其他國內競爭對手。這一預測反映了市場對昇騰技術實力和生態構建能力的強烈認可。
- **生態規模：**昇騰生態的繁榮度是其核心護城河。截至 2026 年，昇思 MindSpore 框架的全球下載量已超 1300 萬次，匯聚了超過 220 萬開發者，並擁有 800 多個行業應用夥伴。這種強大的生態號召力是寒武紀、海光資訊等國內友商短期內難以企及的。
- **全棧自研優勢：**華為是唯一一家能夠提供從底層晶片（昇騰）、AI 框架（MindSpore）、異構計算架構（CANN）到上層應用（盤古大模型）的全棧式、垂直整合解決方案的中國公司。這種“軟硬一體”的模式，使其在面向金融、電力、政務等對自主可控和深度最佳化有極高要求的行業客戶時，具備無可比擬的競爭優勢。
- **競爭格局：**隨著華為市場份額的急劇擴張，預計英偉達在中國的份額將大幅萎縮至 8% 左右。寒武紀等國內廠商雖可能在技術上各有特點，但在生態規模和全棧能力上的差距，使其難以對昇騰構成全面挑戰，預計將主要爭奪剩餘的市場空間。

本章的分析表明，華為昇騰已在中國市場構建起強大的競爭壁壘。其成功不僅依賴於技術層面的系統創新，更得益於其全棧生態的閉環能力和國家算力自主戰略的強力支援。這一競爭格局的確立，為後續分析其產業鏈帶來的巨大投資機遇奠定了堅實基礎。

3. 昇騰 AI 晶片的生態系統建設與商業化落地

華為昇騰的 AI 生態已從早期的“框架適配”演進為“軟硬協同、深度最佳化”的價值兌現階段，其核心壁壘在於透過 CANN 架構與 MindSpore 框架的深度耦合，在特定行業場景中構建起難以複製的“效能-效率”護城河。

昇騰生態的根基是其統一的 AI 計算架構 CANN（Compute Architecture for Neural Networks）與自研 AI 框架 MindSpore（昇思）。市場普遍關注的開發者規模（鯤鵬與昇騰開發者總數已超 665 萬）和模型遷移能力僅是生態的表層。真正的核心在於 CANN 作為硬體與框架之間的橋樑，其底層運算元庫和工具鏈的最佳化程度決定了效能上限。華為透過將 CANN 技術體系全面開源，旨在降低開發者接入門檻，但生態的深度繫結則依賴於 MindSpore 的“原生開發”。

技術棧核心：昇騰生態的技術競爭力源於其靜態圖編譯與軟硬協同的深度最佳化機制。與 PyTorch 的動態圖機制不同，MindSpore 採用靜態圖機制，允許在編譯階段對整個計算流進行深度最佳化，如運算元融合、流水線並行和資料排程，從而最大化硬體利用率。這一特性與昇騰晶片的達芬奇架構形成了完美協同。透過 MindSpore 的靜態圖最佳化、混合精度訓練及內建分散式支援，模型在昇騰硬體上的訓練效能可得到顯著提升。這種“編譯期最佳化”模式，使得昇騰在處理固定計算圖的大模型訓練和推理任務時，能實現更高的能效比，構成了其區別於 CUDA 生態的差異化競爭力。

商業化落地：昇騰生態的商業化成功並非追求在通用 Benchmark 上全面超越對手，而是透過深耕高價值行業場景，將軟硬協同優勢轉化為客戶價值。在金融、工業、網際網路等領域，已湧現出一批標杆案例，證明瞭其強大的客戶粘性。

- **金融風控：**基於昇騰 AI 叢集構建的金融大模型平臺，壞賬識別準確率可達 91%，滿足了金融機構對資料安全、合規性和高穩定性的剛性需求。
- **工業質檢：**在智慧製造場景中，基於昇騰的 AI 質檢方案可將誤檢率控制在 0.2% 以下，實現了降本增效。
- **網際網路與科技：**Qwen-72B 大模型透過昇騰 MindIE 推理工具部署，推理成本可降低至 GPU 方案的 65%；商湯科技將其 SenseCore 大裝置與昇騰 384 超節點成功適配，實現了多租戶、彈性的 AI 雲服務；科大訊飛使用昇騰叢集訓練星火大模型，整體訓練效能提升 17%。

生態佈局：面向更大規模的模型訓練和更廣泛的部署場景，華為正透過“超節點”和“端雲協同”戰略擴充套件生態邊界。

- **超節點架構：**CloudMatrix 384 等超節點方案透過高速互聯匯流排技術，將 384 顆昇騰 910C NPU 整合為統一的“超級計算機”，旨在解決大模型訓練中的記憶體牆和通訊瓶頸問題，實測在 MoE 架構模型訓練中效能可提升 3 倍。
- **端雲協同：**CANN 架構支援端雲協同部署，智譜 GLM 端側模型已完成與 CANN 的適配，驗證了“雲側訓練、端側推理”的可行性，這為昇騰生態從資料中心拓展到邊緣裝置鋪平了道路，進一步增強了其生態的閉環能力。

儘管昇騰生態在運算元覆蓋率等方面與 CUDA 生態仍存在差距，但其透過聚焦核心場景、軟硬深度協同的策略，已成功構建了一個具備強大內生動力的商業閉環，為國產 AI 算力提供了堅實底座。

4. A 股華為昇騰產業鏈全景圖譜

昇騰產業鏈的廣度與深度已形成完整閉環，其價值傳導路徑清晰，從上遊高壁壘的核心元器件到中遊的整機整合與軟體生態，再到下遊的行業應用落地，構成了一個由技術驅動和市場需求共同牽引的龐大產業生態。

4.1 硬體核心供應商

昇騰 AI 晶片的效能高度依賴於系統級創新，這為上遊硬體供應商，特別是在高速互聯、先進封裝、散熱等關鍵環節具備高技術壁壘和國產替代能力的公司，提供了確定性的增長機遇。隨著昇騰 950 系列的量產及未來 960/970 晶片的迭代，單晶片算力與功耗的持續提升，將對配套硬體的效能、工藝和整合度提出更高要求。

- **晶片製造與封測**
 - **中芯國際 (688981)**：作為昇騰晶片的核心晶圓代工廠，其 7nm N+2 及更先進工藝的良率與產能直接決定了昇騰晶片的供給上限。
 - **長電科技 (600584)**：全球封測龍頭，深度參與昇騰 950 系列的先進封裝，其 XDFOI 高密度封裝技術是保障晶片效能的關鍵。
 - **通富微電 (002156)**：在 Chiplet 封裝領域技術領先，深度繫結華為，承接昇騰 AI 晶片的封裝訂單。
 - **偉測科技 (688372)**：作為內資第三方測試龍頭，是昇騰 910/950 晶片 CP/FT 測試環節的主力供應商。
 - **強一股份 (688809)**：華為哈勃參股，其 MEMS 探針卡專供昇騰晶圓測試環節。
- **核心元器件**
 - **高速聯結器**
 - **華豐科技 (688629)**：昇騰高速背板聯結器的絕對核心供應商，市佔率高達 60%-70%。其 112G 產品已獨家量產，224G 產品已於 2026 年 Q1 交付，是保障昇騰超節點內部高速訊號傳輸的“咽喉要道”。
 - **意華股份 (002897)**：昇騰 910C 高速 I/O 聯結器的主要供應商，其板對板聯結器已透過超節點伺服器認證，2026 年 Q1 昇騰相關訂單同比增長超 300%。
 - **光模組**
 - **中際旭創 (300308)**：全球光模組龍頭，為昇騰 384 超節點獨家供應 1.6T 光模組。
 - **光迅科技 (002281)**：國內光器件龍頭，其 800G/1.6T 光模組已透過昇騰認證，並深度參與昇騰算力一體機專案。
 - **華工科技 (000988)**：800G 矽光模組獲華為加單，在昇騰供應鏈中的份額超 30%。
 - **PCB 與封裝基板**
 - **滬電股份 (002463)**：高階伺服器 PCB 龍頭，其高層數 PCB 產品已批次應用於華為昇騰伺服器及超節點。
 - **深南電路 (002916)**：昇騰伺服器 PCB 及封裝基板的核心供應商，深度繫結華為供應鏈。
 - **興森科技 (002436)**：國內 ABF 載板領域的核心企業，是昇騰晶片封裝環節的關鍵材料供應商。
 - **電源管理**

- **泰嘉股份 (002843)**：透過旗下雅達電子成為昇騰伺服器電源的核心供應商。
- **傑華特 (688141)**：昇騰超節點的電源管理晶片核心供應商。
- **散熱 (液冷)**
 - **川潤股份 (002272)**：昇騰 384 超節點液冷解決方案的核心供應商，份額超 52%。
 - **申菱環境 (301018)**：深度繫結華為，提供冷板、CDU 等液冷核心部件。
 - **英維克 (002837)**：國內領先的液冷整合解決方案提供商，受益於智算中心液冷需求增長。
- **儲存與交換**
 - **兆易創新 (603986)**：昇騰伺服器 SSD 儲存供應商。
 - **盛科通訊 (688702)**：自主研發的交換晶片，為昇騰叢集提供網路互聯支援。

4.2 軟體合作夥伴與系統整合商

華為“硬體開放”策略的核心在於賦能合作夥伴，共同將昇騰算力轉化為面向不同行業的解決方案。這一環節的公司是連線昇騰底層算力與上層應用的關鍵橋樑，其技術适配能力、行業理解深度和渠道覆蓋廣度決定了昇騰生態的商業化落地速度與規模。

- **整機與解決方案**
 - **高新發展 (000628)**：透過控股華鯤振宇，成為昇騰伺服器生態的絕對龍頭，市場份額超 50%。作為華為雙領先級認證整機商，其“天宮”系列伺服器是昇騰算力硬體輸出的核心通道。
 - **拓維資訊 (002261)**：華為“昇騰+鯤鵬”雙鑽石級合作夥伴，自研“兆瀚”系列 AI 伺服器，深度參與全國多地智算中心建設。
 - **神州數碼 (000034)**：昇騰生態中兼具整機製造與分銷雙重優勢的核心夥伴，旗下“神州鯤泰”伺服器在政務市場具備強大渠道能力。
 - **烽火通訊 (600498)**：其控股子公司長江計算是鯤鵬昇騰生態的整機合作夥伴，在金融、電信等行業市場佔有率較高。
- **軟體生態與應用使能**
 - **軟通動力 (301236)**：華為昇騰鑽石級 APN 合作夥伴，扮演著生態開發、系統整合與運營服務的多重角色。其不僅作為核心整機夥伴之一，更推出了“睿動 AI”雲平臺和“天璇 2.0”MaaS 平臺，率先完成 DeepSeek-V4 等大模型的部署适配。
 - **潤和軟體 (300339)**：昇思 MindSpore 框架的核心最佳化廠商，在運算元最佳化和 AI 框架适配方面技術積累深厚。
 - **卡萊特 (301391)**：自主研發的算力排程平臺具備對華為 Atlas 800/900 超節點的排程能力，並在華為 384 超節點專案中部署，是昇騰生態中解決算力資源排程的關鍵一環。
 - **恆為科技 (603049)**：提供智算中心的叢集運維與視覺化排程解決方案，確保昇騰算力叢集的穩定高效執行。
 - **東方國信 (300166)**：基於昇騰算力平臺，在金融風控、工業製造等領域提供行業 AI 解決方案。

該產業鏈圖譜清晰地揭示了昇騰產業的傳導邏輯：硬體供應商的業績將率先受益於晶片出貨量的提升，而軟體與整合商的增長則與生態成熟度和商業化落地規模同步。在後續章節中，我們將聚焦於產業鏈中卡位最關鍵、受益最直接的三家核心公司進行深度剖析。

5. 最受惠於昇騰產業發展的三家核心 A 股公司分析

昇騰產業鏈的價值高度集中於三個關鍵節點：伺服器整機市場的絕對份額掌控者、高速互聯環節的技術壟斷者，以及軟體生態與系統整合的核心橋樑。

在華為昇騰從“可用”向“好用”的戰略轉折點上，產業鏈的價值分配呈現高度不均衡。真正具備高業績彈性和長期護城河的公司，並非泛泛的“概念股”，而是在關鍵環節具備**市場主導地位**、**技術不可替代性**和**深度生態繫結**的核心企業。基於對關聯緊密度、訂單規模、技術壁壘及財務資料的綜合研判，**高新發展（000628）**、**華豐科技（688629）**、**軟通動力（301236）** 被篩選為最受惠於昇騰產業發展的三家核心 A 股公司。它們分別代表了昇騰算力從硬體整合、核心互聯到行業落地的三個不同維度，共同構成了產業閉環的核心支柱。

篩選標準與核心標的定位

- **市場主導地位**：在所屬細分領域佔據絕對領先的市場份額，直接受益於昇騰算力基礎設施的規模化擴張。
- **技術不可替代性**：產品具備高技術壁壘，深度參與昇騰核心技術的協同迭代，短期內難以被替代。
- **生態核心角色**：在華為構建的“硬體開放、軟體開源”生態中扮演關鍵角色，是連線華為技術與終端使用者的核心通道。
- **財務增長驗證**：已透過強勁的財務資料，驗證了其受益於昇騰產業發展的邏輯，展現出明確的業績彈性。

下表概述了這三家公司的核心定位與競爭優勢：

公司名稱	產業鏈定位	核心競爭優勢	與昇騰關聯的關鍵指標
高新發展 (000628)	昇騰伺服器整機龍頭	透過控股華鯤振宇，佔據昇騰伺服器市場超 50%份額，是華為算力硬體輸出的核心通道。	市場份額領先，深度繫結字節跳動、三大運營商等頭部客戶，2026 年訂單飽滿。
華豐科技 (688629)	高速互聯核心供應商	昇騰伺服器高速背板聯結器絕對龍頭，市佔率超 70%，技術壁壘極高，是保障超節點內部高速通訊的“神經中樞”。	華為第一大客戶，業務佔比高達 60.52%；112G 產品獨家量產，224G 產品即將交付，單機價值量顯著提升。
軟通動力 (301236)	軟體生態與整合核心夥伴	華為昇騰鑽石級 APN 合作夥伴，兼具軟體生態最佳化、MaaS 平臺運營與系統整合能力，是推動昇騰在各行業落地的關鍵實施者。	旗下軟通華方為昇騰核心整機夥伴之一；睿動 AI 平臺率先完成 DeepSeek-V4 部署，政務、金融等領域大額訂單規模超 15 億。

高新發展（000628）：昇騰伺服器生態的領軍者

高新發展（000628）透過控股子公司華鯤振宇，已成為昇騰伺服器生態中不可動搖的領導者。其核心價值在於將華為的昇騰晶片轉化為市場接受的標準化、規模化伺服器產品，並憑藉其強大的渠道能力和品牌影響力，佔據了國內昇騰伺服器市場的半壁江山。隨著昇騰 950 系列晶片在 2026 年進入大規模量產階段，高新發展（000628）作為核心整機夥伴，其業績增長具備極高的確定性。

華豐科技（688629）：高速互聯關鍵節點的“隱形冠軍”

華豐科技（688629）的價值體現在其對昇騰 AI 叢集效能發揮的決定性作用上。在 AI 超節點架構中，算力瓶頸已從單晶片轉向互聯通訊，而華豐科技（688629）提供的高速背板聯結器是實現機櫃內多張加速卡高速、低延遲資料交換的關鍵物理基礎。其高達 70% 的市場佔有率 和與華為的聯合研發關係，構築了深厚的護城河。隨著昇騰晶片互聯頻寬從 950PR 的 2TB/s 向 970 的 4TB/s 演進，對高速聯結器的效能要求和需求量將持續提升，驅動公司價值與業績同步增長。

軟通動力（301236）：昇騰軟體生態與整合的核心橋樑

軟通動力（301236）的戰略意義在於打通了昇騰底層算力與上層行業應用之間的“最後一公里”。它不僅是華為的鑽石級軟體夥伴，深度參與昇思（MindSpore）框架的最佳化與應用開發，更透過其系統整合和行業解決方案能力，將昇騰算力成功部署到金融、政務、運營商等關鍵領域。其率先完成對 DeepSeek-V4 等主流大模型的適配，證明瞭其在 AI 應用使能方面的領先地位，是昇騰生態從技術驗證走向大規模商業化落地的核心催化劑。

這三家公司分別從硬體整合、核心部件和軟體應用三個層面，構築了昇騰產業鏈最堅實的價值核心。它們的篩選為後續章節深入剖析其商業模式、財務表現及未來增長路徑提供了明確的標的框架。

6. 高新發展 (000628)：昇騰伺服器生態的領軍者

高新發展 (000628) 透過控股華鯤振宇，已成為華為昇騰伺服器生態中佔據絕對市場份額的硬體輸出主渠道，其業績增長與昇騰算力需求高度繫結，確定性極強。

6.1 戰略定位與核心競爭力

高新發展 (000628) 透過其控股的華鯤振宇，確立了在華為昇騰生態中作為核心整機夥伴的戰略定位。這一地位的形成源於華鯤振宇與華為的深度繫結，使其成為昇騰算力從晶片轉化為市場可用伺服器硬體的最主要通道。其核心競爭力在於先發優勢與規模效應，作為華為“雙領先級”認證的整機商，華鯤振宇憑藉其“天宮”系列伺服器產品線，全面覆蓋了從邊緣到資料中心的各種算力場景，並深度參與了多個國家級和省級智算中心的建設，構築了強大的品牌認知度和渠道優勢。在國產替代浪潮下，這種與華為的緊密合作關係形成了極高的準入壁壘，使其在競爭中佔據主導地位。

6.2 市場地位與財務表現

高新發展 (000628) (華鯤振宇) 在昇騰伺服器市場擁有領導性地位，市場份額遙遙領先。根據行業報告，其在國內昇騰伺服器市場的佔有率已超過 50%，是名副其實的行業龍頭。這一市場地位直接轉化為強勁的財務增長，其 2025 年第一季度營收同比大幅增長 172%，驗證了昇騰 AI 算力市場需求的爆發式增長。

核心客戶羣體：

- **網際網路巨頭：** 如字節跳動等頭部企業，已向華鯤振宇下達大規模昇騰伺服器訂單，以滿足其龐大的 AI 推理和訓練需求。
- **電信運營商：** 中國移動、中國電信、中國聯通等運營商是智算中心建設的主力軍，與華鯤振宇有深度合作。
- **政府與行業智算專案：** 在政務雲、智慧城市、金融、能源等領域的智算中心建設中，華鯤振宇憑藉其產品與解決方案能力，獲得了高市場份額。

展望未來，隨著昇騰 950 系列晶片在 2026 年進入大規模量產階段，以及後續 960/970 晶片的迭代，高新發展 (000628) 作為昇騰伺服器生態的領軍者，其市場地位和財務表現有望得到持續鞏固和提升。

7. 華豐科技（688629）：高速互聯關鍵節點的“隱形冠軍”

華豐科技（688629）憑藉其在高速背板聯結器領域的技術壟斷性地位，已成為華為昇騰超節點架構中保障算力無損互聯的“隱形冠軍”，其業績增長與華為算力擴張曲線高度擬合。

7.1 戰略定位與核心競爭力

華豐科技（688629）的戰略價值根植於其在高速互聯這一 AI 算力“咽喉要道”中的不可替代性。昇騰 AI 晶片的設計哲學是透過強大的互聯能力構建叢集優勢，以系統級創新彌補單晶片在製程上的短板，這使得聯結器不再是無源元件，而是決定叢集算力效率的關鍵。華豐科技（688629）的核心競爭力在於其構建了多維度的技術護城河：

- **技術壁壘與國產替代**：高速背板聯結器是實現伺服器內部多張加速卡高速、高密度、低延遲互聯的核心物理基礎，其訊號完整性、傳輸速率和可靠性直接影響 NPU 的協同計算效率。該領域技術壁壘極高，長期被海外廠商壟斷。華豐科技（688629）是國內少數掌握 112Gbps 及以上速率聯結器核心技術並實現大規模量產的企業，其產品效能直接對標國際領先水平，成為昇騰供應鏈中實現國產替代的關鍵環節。
- **與華為的深度繫結與聯合研發**：華豐科技（688629）與華為的合作關係已超越普通供應商範疇，演變為深度聯合研發的戰略夥伴。華為透過旗下哈勃投資持有華豐科技（688629）2.95%的股份，形成了資本層面的深度繫結。更重要的是，雙方在產品開發早期階段即進行技術協同，確保聯結器方案與昇騰晶片的互聯需求（如靈衢匯流排協議）完美匹配。這種“你中有我”的合作模式，使得新供應商極難在短期內透過認證並切入供應鏈，構築了強大的客戶粘性。
- **產品迭代與架構依賴**：華豐科技（688629）的產品迭代速度與昇騰晶片的演進節奏緊密同步。在 112G 高速背板聯結器已實現獨家量產的基礎上，其 224G 產品已於 2026 年第一季度交付華為，以匹配昇騰 950 系列高達 2TB/s 的互聯頻寬需求。隨著昇騰 960/970 的釋出，對更高速率（如 448G）聯結器的需求將持續驅動其產品價值量提升。在華為的超節點（SuperPod）架構中，無論是機櫃內的 PCB+銅纜互聯，還是機櫃間的光銅混合組網，華豐科技（688629）的高速聯結器與線模組都是實現 Mesh 網路拓撲不可或缺的基礎元件，其在系統中的地位無可替代。

7.2 財務表現與客戶分析

華豐科技（688629）與華為的戰略協同效應已直接轉化為強勁的財務增長，其業績表現成為觀測昇騰 AI 算力出貨量的高靈敏度指標。

- **業績爆發式增長**：2025 年，公司實現營收 25.28 億元，同比增長 131.50%；歸母淨利潤從 2024 年的虧損 1775 萬元大幅扭虧至 3.59 億元。這一增長勢頭在 2026 年第一季度得以延續，營收達到 6.33 億元（同比+56.15%），歸母淨利潤為 1.05 億元（同比+230.43%）。業績的爆發式增長，驗證了昇騰算力需求正沿著產業鏈向上遊核心部件快速傳導。
- **華為供應鏈的絕對主導地位**：華為作為公司第一大客戶，其戰略重要性在財務資料中體現得淋漓盡致。2025 年，華豐科技（688629）對華為的銷售額達到 15.3 億元，佔公司總營收的 60.52%。這一資料不僅印證了雙方合作的深度，也凸顯了華豐科技（688629）在華為昇騰供應鏈中的核心地位。市場普遍認為，其在華為昇騰高速聯結器領域的市場份額已超過 70%。
- **單機價值量顯著提升**：AI 伺服器對高速互聯的需求遠超傳統伺服器，導致單臺伺服器所用聯結器和線模組的價值量呈數倍增長。隨著昇騰超節點（如

CloudMatrix 384) 的普及，單套節點對高速模組的需求量巨大（如 40 萬套），單套價值量可達 1.5 萬元以上，這為華豐科技（688629）帶來了巨大的收入彈性。

7.3 風險與挑戰

儘管華豐科技（688629）憑藉與華為的深度繫結獲得了巨大的增長動能，但這種高度集中的業務模式也帶來了相應的風險與挑戰。

- **客戶集中度風險：**對單一客戶（華為）高達 60.52% 的營收依賴是公司最主要的風險敞口。這意味著華為自身的經營狀況、戰略調整或供應鏈策略的任何變化，都可能對華豐科技（688629）的訂單量和業績穩定性產生直接且重大的影響。公司 2025 年年報亦明確提示了“公司對華為的依賴程度較高”的風險。
- **供應鏈策略變化風險：**為保障供應鏈安全和成本控制，華為有引入第二供應商的慣例。儘管高速聯結器領域的技術壁壘和認證週期為新進入者設定了高門檻，但航天電器等潛在競爭者已在進行相關測試，未來不排除華為會扶持二供以平衡供應鏈，這可能對華豐科技（688629）的議價能力和市場份額構成挑戰。
- **技術迭代不及預期風險：**華豐科技（688629）的業績增長高度依賴於昇騰晶片的持續成功迭代和 AI 伺服器市場的持續高景氣度。如果昇騰後續產品（如 960/970）因技術或製造問題延遲釋出，或全球 AI 算力投資增速放緩，將直接影響對公司聯結器產品的需求，導致業績增長不及預期。

本章對華豐科技（688629）的分析揭示了其作為昇騰產業鏈關鍵節點的核心價值。然而，一個完整的算力系統不僅需要高速互聯，更需要強大的硬體載體。下一章將聚焦於將這些核心部件整合為完整算力輸出的伺服器整機環節，分析其市場格局與領軍者的戰略地位。

8. 軟通動力（301236）：昇騰軟體生態與整合的核心橋樑

軟通動力（301236）並非簡單的昇騰算力分銷商，而是將華為底層 AI 硬體能力轉化為千行百業上層應用解決方案的核心使能平臺與生態橋樑。

8.1 戰略定位與核心競爭力

軟通動力（301236）的戰略價值在於其獨特的“平臺+生態”雙重角色，有效解決了國產算力從“硬體部署”到“業務賦能”的最後一公里問題。其核心競爭力並非單一的技術或產品，而是一種深度繫結華為、覆蓋全棧的整合與使能力。

昇騰生態的深度繫結與全棧能力：作為華為昇騰的鑽石級 APN 合作夥伴，軟通動力（301236）是少數同時具備生態開發、產品方案、系統整合與運營服務能力的公司之一。這種深度繫結使其能夠優先獲取華為最新的技術與產品路線圖，從而進行前瞻性的應用開發與最佳化。其業務貫穿了從底層昇思（MindSpore）框架的最佳化，到基於昇騰算力構建自主的 MaaS 平臺和 AI 應用，再到面向最終客戶提供系統整合與解決方案的全過程，形成了軟硬體協同的閉環服務模式。

連線底層算力與上層行業應用的平臺化模式：公司的核心商業模式是構建平臺化的解決方案，以降低企業客戶使用昇騰算力的門檻。透過打造“天璇 2.0”MaaS 平臺和睿動 AI 智慧體雲平臺，軟通動力（301236）將昇騰的硬體算力、MindSpore 框架以及行業知識庫封裝成標準化的服務。這種模式使得客戶無需深入鑽研底層技術細節，即可快速部署和執行 AI 模型，從而將昇騰的硬體效能優勢高效轉化為客戶的業務價值，在推動昇騰落地各行各業中扮演了關鍵角色。

8.2 市場地位與業務進展

軟通動力（301236）憑藉其廣泛的行業覆蓋和大型專案交付能力，已在昇騰生態中佔據了難以替代的市場地位，其業務進展直接反映了昇騰 AI 商業化落地的廣度與深度。

廣泛的行業滲透與標杆案例：公司的業務已深度滲透政務、金融、運營商、網際網路等多個關鍵 AI 應用領域。在政務市場，軟通動力（301236）是多個國家級、省級智算中心專案的核心服務商；在金融領域，其為多家銀行及金融機構提供了基於昇騰的 AI 解決方案。截至 2025 年底，昇騰生態已產生超過 23900 個認證解決方案，軟通動力（301236）作為核心 ISV（獨立軟體開發商），是這些方案落地的重要推動力量。

大規模訂單與平臺化服務的驗證：其市場地位得到了顯著訂單規模的驗證。公司在政務、金融及運營商等領域的訂單總規模已超過 15 億元。同時，其平臺化服務模式已成功驗證，旗下軟通華方作為昇騰核心整機夥伴之一，實現了從硬體到軟體的全棧服務。其睿動 AI 平臺更是國內首批完成對 DeepSeek-V4 這類頂尖大模型部署適配的平臺，服務客戶已超 200 家，並完成了 30 個國產化替代專案，這充分證明瞭其技術實力和市場認可度。

9. 核心三家公司未來三年（2026-2028）發展狀況推演

昇騰晶片的迭代節奏與商業化程式將成為高新發展（000628）、華豐科技（688629）與軟通動力（301236）未來三年業績增長的核心驅動力，但三家公司將分別展現出“規模擴張”、“技術驅動”與“生態滲透”三種截然不同的增長正規化。

9.1 高新發展（000628）：伴隨昇騰放量持續成長，關注資產整合

高新發展（000628）（透過控股華鯤振宇）作為昇騰伺服器生態的出口，其增長曲線將與昇騰晶片的出貨量高度耦合，呈現典型的規模驅動特徵。

- **2026 年：訂單飽滿，業績爆發式增長**

隨著昇騰 950PR 在 2026 年 Q1 商用及下半年全面出貨，預計全年出貨量將達到 75 萬片，華為在中國 AI 晶片市場的份額有望衝擊 50%。高新發展（000628）憑藉其超 50% 的昇騰伺服器市場份額，將直接承接來自字節跳動、三大運營商及各地智算中心的海量訂單。其 2025 年 Q1 營收同比+172% 的高增長態勢將在 2026 年得以延續，業績確定性極強。

- **2027 年：新品驅動，增長動力持續**

昇騰 960 的釋出將成為關鍵催化劑。隨著 960 在 2027 年 Q4 推出，其算力相較於 950 系列實現翻倍，將引發新一輪的伺服器升級與擴容需求。高新發展（000628）的“天宮”系列伺服器將同步更新，憑藉其強大的渠道優勢和品牌認知度，有望維持市場領先地位，增長動力從 950 系列的“從 0 到 1”放量，切換至 960 系列驅動的“從 1 到 N”的持續滲透。

- **2028 年：龍頭鞏固，關注整合與新增長點**

昇騰 970 的釋出將進一步鞏固華為在國內算力市場的技術領先地位。高新發展（000628）作為昇騰伺服器生態的領軍者，其市場地位將難以撼動。此階段，市場將高度關注其將華鯤振宇資產完全注入上市公司的進展。同時，隨著 AI 算力市場進入成熟期，公司需要尋找新的增長點，例如向算力運營、行業解決方案等價值鏈下游延伸，以實現從高速增長向高質量穩定增長的過渡。

9.2 華豐科技（688629）：技術迭代驅動價值提升，橫向拓展可期

華豐科技（688629）的增長邏輯根植於昇騰晶片對高速互聯效能的極致追求，其業績將由“量價齊升”和“技術代差”共同驅動，展現出最強的業績彈性。

- **2026 年：224G 產品放量，業績延續高增長**

作為昇騰超節點高速背板聯結器的核心供應商（市佔率超 70%），華豐科技（688629）將直接受益於昇騰 950 系列伺服器對高速互聯需求的激增。其獨家量產的 112G 產品將進入全面收穫期，而支援更高傳輸速率的 224G 聯結器即將交付，這將帶動單臺伺服器價值量顯著提升。結合華為 2026 年龐大的伺服器出貨目標，其 2025 年營收同比+131.5% 的強勁增長勢頭將在 2026 年得到延續。

- **2027 年：技術領先優勢擴大，增長動能強勁**

昇騰 960/970 對互聯頻寬提出了更高要求（970 將達到 4TB/s），這將進一步拉大華豐科技（688629）在高速聯結器領域的技術護城河。其與華為聯合研發的深度繫結關係，確保了其在下一代產品上的先發優勢。隨著國產算力叢集規模的不斷擴大，對高速、低延遲互聯的需求將持續增長，華豐科技（688629）作為關鍵節點的“隱形冠軍”，其增長動能將依然強勁。

- **2028 年：拓展第二增長曲線，尋求橫向突破**

在穩固了華為供應鏈的絕對龍頭地位後，華豐科技（688629）將面臨如何突破單一客戶依賴的課題。其憑藉在高速聯結器領域積累的核心技術，有望將產品成功拓展至其他國產算力平臺（如海光、寒武紀）以及更廣泛的高速計算領域（如資料中

心交換機、高效能運算）。屆時，其成長邏輯將從“受益於華為算力擴張”升級為“賦能整個國產高速計算生態”，成功與否將決定其長期估值空間。

9.3 軟通動力（301236）：生態深化與行業滲透共促增長

軟通動力（301236）的增長並非源於硬體銷售，而是依賴於昇騰生態的繁榮程度和 AI 應用在各行各業的落地深度，其增長曲線將更為平緩但可能更具持續性。

- **2026 年：深耕核心行業，大型專案集中交付**

作為華為昇騰鑽石級 APN 合作夥伴，軟通動力（301236）將率先受益於昇騰生態的早期商業化紅利。其“天璇 2.0”MaaS 平臺和睿動 AI 智慧體雲平臺將深度參與政務、金融、運營商等領域的首批大型 AI 專案交付。這些早期專案雖然規模龐大（訂單超 15 億），但具有較強的定製化屬性，主要任務是幫助頭部客戶完成從傳統架構到昇騰平臺的遷移與適配。

- **2027 年：向長尾行業滲透，服務模式深化**

隨著昇騰生態的成熟和 MindSpore 框架的普及，AI 應用開發的門檻將逐步降低。軟通動力（301236）的業務重心將從服務大型客戶，轉向為更多“長尾”行業提供標準化的 AI 解決方案和平臺服務。其服務模式也將從專案制開發，逐步轉向提供運營、維護和持續最佳化的訂閱制服務，這將使其收入結構更加穩定，增速可能放緩但更具可持續性。

- **2028 年：構築平臺化能力，提升客戶黏性**

經過數年的行業深耕，軟通動力（301236）將積累起豐富的 AI 模型資產和行業解決方案庫。屆時，其核心競爭力將不再是單純的軟體開發能力，而是基於昇騰底座的平臺化、可複用的 AI 服務能力。透過構建強大的客戶黏性，軟通動力（301236）有望成為連線華為底層算力與千行百業上層應用的核心橋樑，其商業模式將更加成熟，利潤率也有望透過平臺化運營得到提升。

10. 總結與展望：昇騰產業浪潮下的核心機遇與未來格局

本報告系統性地分析了華為昇騰 AI 晶片的技術演進路徑、核心競爭力、生態系統建設，並全面梳理了其輻射的 A 股產業鏈。基於深度研判，我們篩選出最受惠的三家核心公司，並對其未來發展進行了推演。核心結論與展望如下。

10.1 昇騰 AI 晶片：以系統級創新重塑國產算力競爭格局

華為昇騰 AI 晶片的成功並非依賴於單點技術的突破，而是源於其“以通訊補算力、以系統補單點”的系統級創新戰略。透過自研 HBM 技術、靈衢互聯協議、SIMD/SIMT 雙程式設計模型以及全格式精度支援的協同最佳化，昇騰構建了一個即便在不依賴最先進製程的情況下，依然具備強大競爭力的自主算力體系。這一非對稱競爭策略，使其在中國市場成功開闢了差異化賽道，預計到 2026 年將佔據國內 AI 晶片市場的半壁江山，從根本上改變了由國際巨頭主導的競爭格局。

10.2 產業鏈價值傳導：硬體先行，軟體與應用緊隨其後

昇騰產業的崛起正沿著一條清晰的價值鏈向上遊核心元器件和下遊軟體整合與服務商傳導。

- **硬體環節率先受益：**隨著昇騰 950 系列在 2026 年進入大規模量產，以及後續 960/970 晶片對效能的持續迭代，上遊的晶片製造與封測、高速聯結器、光模組、PCB 及散熱等核心硬體供應商將率先迎來確定性的訂單增長。其中，具備高技術壁壘和深度繫結的核心供應商，將展現出最強的業績彈性。

- **軟體與服務環節同步成長**：昇騰生態的商業化落地，則依賴於軟體合作夥伴和系統整合商將底層算力轉化為千行百業的解決方案。隨著生態的成熟，這部分企業的價值將逐步釋放，其增長雖相對平緩，但市場空間更為廣闊，且具備更強的客戶粘性。

10.3 三大核心標的：構築產業閉環的戰略支柱

高新發展（000628）、華豐科技（688629）和軟通動力（301236）分別代表了昇騰產業鏈中硬體整合、核心部件和軟體應用三個最關鍵、價值最集中的環節，形成了互補的戰略支柱。

- **高新發展（000628）**：作為昇騰伺服器市場的絕對龍頭，是華為算力硬體輸出的核心通道，其增長與昇騰晶片的出貨量高度繫結，呈現典型的規模驅動特徵。
- **華豐科技（688629）**：作為高速互聯環節的“隱形冠軍”，其產品是保障昇騰超節點算力無損發揮的“神經中樞”。其增長由技術迭代驅動，展現出“量價齊升”的高彈性。
- **軟通動力（301236）**：作為連線華為底層算力與上層行業應用的核心橋樑，是推動昇騰 AI 商業化落地的關鍵實施者。其增長依賴於生態的滲透深度，具備更強的可持續性。

10.4 未來三年（2026-2028）發展推演：從高速增長到生態深化

展望未來三年，昇騰晶片的持續迭代將是整個產業鏈發展的核心驅動力，三家核心公司將展現出不同的增長正規化。

- **2026 年：全面放量，業績兌現**。隨著昇騰 950 系列全面出貨，產業鏈將迎來業績的集中爆發期。高新發展（000628）訂單飽滿，華豐科技（688629）224G 產品開始放量，軟通動力（301236）進入大型專案交付高峯。
- **2027 年：技術驅動，持續增長**。昇騰 960 的釋出將引發伺服器升級換代需求，為高新發展（000628）提供持續增長動力。同時，更高的互聯要求將進一步鞏固華豐科技（688629）的技術領先地位。軟通動力（301236）的業務則開始向更多長尾行業滲透。
- **2028 年：格局穩固，尋求突破**。隨著昇騰 970 的釋出，華為在國內算力市場的技術領先地位將得到鞏固。高新發展（000628）將鞏固其龍頭地位，華豐科技（688629）有望成功拓展第二增長曲線，而軟通動力（301236）將透過平臺化運營構築強大的客戶黏性。

10.5 投資策略建議：聚焦核心，長期佈局

基於以上分析，我們建議投資者採取以下策略：

1. **聚焦核心環節**：優先關注產業鏈中具備市場主導地位、技術不可替代性或生態核心角色的龍頭企業。這些公司能夠最大程度地分享昇騰產業發展的紅利，並具備更強的抗風險能力。
2. **把握增長節奏**：理解產業鏈不同環節的價值傳導時序。硬體供應商的業績彈性在早期階段更為顯著，而軟體與服務商的長期增長空間則隨著生態的成熟而不斷擴大。
3. **關注長期價值**：昇騰 AI 產業的發展是一個長期過程。投資者應著眼於企業的核心競爭力、技術護城河以及與華為生態的繫結深度，進行長期戰略性佈局，而非僅關注短期訂單波動。